

マルチスパッタ装置 SP-3300M



本装置は3源スパッタ装置で、各カソードにおいてRFとDC2つのソースを使用することが出来ます。またRFとDCの同時スパッタ成膜も可能です。基板ヒーターはマイクロセラミックヒーターを採用しておりますので、300℃迄短時間で昇温します。大きなオペレートタッチ画面と、初心者でも簡単に操作可能な排気系の自動操作、誤動作防止のための安全回路を搭載。ドライポンプ+ターボ分子ポンプによるクリーンな排気において、金属膜、酸化膜、絶縁膜の良質な成膜が可能です。

マルチスパッタ装置SP-3300M仕様

○到達圧力	7.0×10 ⁻⁵ Pa以下※常温・無負荷・脱ガス時
○成膜室径	φ350mm×357mmH SUS304 電解研磨
○LL室径	φ150mm×250mmL 電解研磨
○スパッタ用電源	RF電源 13.56MHz 300W 自動マッチング 1台 DC電源 1200V 500W 1台
○逆スパッタ機構	有り
○基板形状	□30mm 1枚
○膜厚分布	±5%以内
○ターゲット寸法	3インチ(金属・酸化物・絶縁物)
○ターゲット個数	3
○基板回転	有り
○TS間距離	50～100mmの間にて可変可能
○基板加熱	常温～300℃迄昇温可能
○真空排気系	ドライポンプ:360L/min ターボ分子ポンプ:300L/sec
○操作方法	自動/手動選択可能
○ガス系統	マスフローコントローラ 2系統
○ユーティリティ	電気:AC200V三相8KVA 冷却水:10L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環 計装エア:0.5MPa以上 寸法: 装置架台本体:1120mmW×725mmD×(1750)mmH 制御盤:570mmW×1000mmD×(1850)mmH